



ON EN 61190-1-3	C7
ON EN ISO 9453	Legierungsnr. 401
ON EN ISO 3677	S-Sn99Cu1 227
vormals DIN 1707	-
vormals AFNOR NF A 81-362	-
vormals QQ-S-571	-
Zusammensetzung	Sn 99,3 % / Cu 0,7 %
Solidus	227 °C
Liquidus	227 °C
Arbeitstemperatur	280 °C
Dichte (kg/dm <sup>3</sup> )	7,3
Brinell-Härte (HB)	14
Ausdehnungskoeffizient [(1/K)·10 <sup>6</sup> ]	-
Elektrische Leitfähigkeit (m/Ω·mm <sup>2</sup> )	7,5
Zugfestigkeit	Kupfer: 60 MPa Messing: 50 MPa Stahl: 40 MPa
Scherfestigkeit	Kupfer: 30 MPa Messing: 20 MPa Stahl: 25 MPa

**Lieferformen:**

Lotdrähte Ø 0,5 bis 3mm  
Röhrenlote Ø 0,5 bis 3mm mit Flussmittel nach DIN EN 29454 bzw. ISO 9454-1 vormals DIN 8511 oder andere Spezifikationen.  
Lotstäbe, Lotstangen, Lotbarren, Lotfolie, Ring- und Stanzformteile.

**Anwendung**

Werkstoffe: Kupfer, Kupferlegierungen, Messing, Nickel, Nickellegierungen, Stähle, Edelstähle  
Branchen: Elektronik, Elektrotechnik, Metallwaren, Feinmechanik, Luft- und Raumfahrttechnik, Apparatebau.  
Gute Wärme- und Kältebeständigkeit, gut geeignet für Stufenlötungen